

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	2026年1月23日 安信基金、博道基金、淡马锡投资、光大永明资管、国泰基金、嘉实基金、金鹰基金、平安基金、上银基金、招商基金等
时间	2026年1月23日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有

丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。

根据公司披露的《2025 年年度业绩预告公告》，公司预计 2025 年度实现营业收入约 31.53 亿元，较 2024 年度增长 35.81%；随着收入快速增长，公司盈利能力不断提高，预计 2025 年全年亏损同比收窄 1.52 亿元，收窄比例为 25.29%。

订单方面，2025 年第二、第三、第四季度新签订单金额分别为 11.82 亿元、15.93 亿元、27.11 亿元，单季度新签订单金额三次突破历史新高，其中 2025 年第四季度较第三季度进一步增长 70.17%。2025 年全

	<p>年，公司新签订单金额 59.60 亿元，同比增长 103.41%，其中 AI 算力相关订单占比超 73%，数据处理领域订单占比超 50%。</p> <p>截至 2025 年末，公司在手订单金额达到 50.75 亿元，较三季度末的 32.86 亿元大幅提升 54.45%，且已连续九个季度保持高位。公司 2025 年末在手订单中，量产业务订单超 30 亿元，量产业务的规模效应显著，订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。2025 年末在手订单中，预计一年内转化的比例超 80%，且近 60% 为数据处理应用领域订单。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司在手订单按照应用领域来看大概是什么结构？</p> <p>回复：截止 2025 年第四季度，公司在手订单金额为 50.75 亿元，主要分布在数据处理、物联网、消费电子领域。在手订单中，近 60% 为数据处理应用领域订单；此外，受到 AI 端侧需求增加，来自于物联网、消费电子领域的客户需求也成为推动公司在手订单稳步增长的重要动力。</p> <p>问题：请问公司目前与云服务提供商、互联网厂商等客户的合作情况如何？</p> <p>回复：近年来，互联网公司、云服务提供商、车企等系统厂商因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺的原因多寻求与芯片设计服务公司进行合作。</p> <p>芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设计服务合作伙伴之</p>

一。2025年前三季度，来自上述系统厂商客户的收入占比 40.36%；截至三季度末，公司在手订单中 83.52%来自于上述系统厂商客户。

问题：请问公司认为未来业绩增长主要由哪些领域需求驱动？

回复：近年来，随着人工智能技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（AIGC）模型的广泛应用，半导体产业迎来了高速增长期。AI ASIC 凭借其定制化架构、高计算密度和低功耗特性，可以在特定场景中实现高性价比和低功耗，正成为市场增长的核心驱动力。2025 年全年，公司新签订单金额 59.60 亿元，同比增长 103.41%，其中 AI 算力相关订单占比超 73%，预计未来 AI 算力相关领域的客户需求将驱动公司业绩增长。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AI/AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。作为“AI ASIC 龙头企业”，芯原在云端算力（训练和推理）芯片定制领域已建立起显著优势；面向未来，公司将在持续服务数据中心、高性能计算等市场需求的同时，大力拓展端侧 AI 市场，为端侧 AI 微调和推理提供高效的算力支持。

问题：请问公司在 AI 眼镜领域有哪些技术积累和业务进展？

回复：在边缘人工智能终端产品中，以 AI/AR 眼镜为代表的智慧可穿戴设备被认为是继智能手机之后的下一个十亿级出货量的产品，这类设备可搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力，创新人们的数字生活和社交。芯原拥有面向相关领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。目前，在 AI/AR/VR 眼镜领

	<p>域，公司已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AI/AR/VR 客户正在与芯原进行合作。</p>
--	---